

Title (en)

Lead-copper alloy.

Title (de)

Blei-Kupfer-Legierung.

Title (fr)

Alliage à base de plomb et de cuivre.

Publication

EP 0040649 A1 19811202 (DE)

Application

EP 80200481 A 19800522

Priority

EP 80200481 A 19800522

Abstract (en)

In order to improve the mechanical and technological properties of a lead-copper alloy containing 0.03 to 0.08 % by weight of copper in the manufacture of sheets and strips for the construction industry, this alloy additionally contains 0.005 to 0.05 % by weight of selenium. <IMAGE>

Abstract (de)

Um bei einer Blei-Kupfer-Legierung mit 0,03 bis 0,08 Masse-% Kupfer zur Herstellung von Blechen und Bändern für das Bauwesen die mechanischen und technologischen Eigenschaften zu verbessern, enthält diese noch 0,005 bis 0,05 Masse-% Selen.

IPC 1-7

C22C 11/04

IPC 8 full level

C22C 11/04 (2006.01)

CPC (source: EP)

C22C 11/04 (2013.01)

Citation (search report)

Zeitschrift für Metallkunde, Band 70 Nr. 12, 1979 Stuttgart U. HEUBNER "Die Kornfeining und Gefugestabilisierung von Blei und Bleilegierungen mit Hilfe von Schwefel, Selen und Tellur" seiten 761 bis 767 * seiten 764, 765 766 *

Cited by

CN110129615A; GB2169616A

Designated contracting state (EPC)

AT BE DE FR NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0040649 A1 19811202

DOCDB simple family (application)

EP 80200481 A 19800522